Sensitive Volume Modeling in Calculation of Space Radiation-Induced SEU Cross Section

S. Boorboor¹, S. A. H. Feghhi^{2*} and H. Jafari³

1-3. Department of Radiation Application, Department of Nuclear Engineering, Shahid Beheshti University

Postal Code: 1983963113, Tehran, IRAN

a_feghhi@sbu.ac.ir

Shape and size of sensitive volume are the most important parameters to model electronic devices for calculation of the SEU rate from space radiations. So far different models have been proposed for estimation of the sensitive volume. In this work, results of three models including RPP, Tetrahedral and Nested in calculation of sensitive volume have been compared with experimental result for AT60142 SRAM. GEANT4 as a Monte Carlo code has been used to calculate energy loss and energy straggling of ions with considering metallization and oxide layers. Comparisons between Monte Carlo and experimental results shows that RPP model estimates the SEU cross section with a large deviation in whole LET range, tetrahedral has good response in low LET's but don't follow experimental result for high LET particles and nested sensitive volume produce acceptable results for whole of LET range.

Keywords: GEANT4, Sensitive volume, SEU damage, SRAM

^{1.} M.Sc. Student

^{2.} Associat Professor (Corresponding Athour)

^{3.} M.Sc.

JSSST

مدلسازی حجم حساس در محاسبهٔ سطح مقطع آسیب پرتویی SEU ناشی از پرتوهای فضایی

سعید بوربور^۱، سیدامیرحسین فقهی^۲* و حمید جعفری^۳

۱، ۲ و ۳- گروه کاربرد پرتوها، دانشکدهٔ مهندسی هستهای، دانشگاه شهید بهشتی

* تهران، کد پستی ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳

a_feghhi@sbu.ac.ir

یکی از مهمترین پارامترها در محاسبهٔ سطح مقطع آسیب SEU ناشی از پرتوهای فضایی، شکل و اندازهٔ حجم حساس سلول حافظهٔ الکترونیکی است. تاکنون مدلهای مختلفی برای محاسبهٔ حجم حساس ارائه شده است، لیکن ارزیابی جامعی از میزان انطباق نتایج حاصل از به کارگیری این مدلها با نتایج تجربی صورت نگرفته است. در این مقاله، نتایج حاصل از مدلهای Petrahedral رو Nested Sensitive Volume برای محاسبهٔ حجم حساس سلول حافظهٔ الکترونیکی مقایسه میشود. در این محاسبات، اثر لایههای فلزی و محاسبهٔ حجم حساس سلول حافظهٔ الکترونیکی مقایسه میشود. در این محاسبات، اثر لایههای فلزی و اکسیدی و همچنین اثر پهن شدگی انرژی درنظرگرفته شده است. این محاسبات با استفاده از کد مونت کارلو الکترونیکی GEAN14 سبانگر این است که مدل RPP اختلاف زیادی با نتایج آزمایشهای عملی دارد و الکترونیکی Interhedral به وجود پاسخ نسبتا قابل قبول در RPP اختلاف زیادی با نتایج آزمایشهای عملی دارد و مدل Interhedral با وجود پاسخ نسبتا قابل قبول در IET های کم در IET های بالا همچنان اختلاف زیادی با نتایج آزمایشهای عملی نشان میدهد. در نهایت مدل IEE های کم در IEE های بالا همچنان اختلاف زیادی با نتایج آزمایشهای عملی نشان میدهد. در نهایت مدل IEE های کم در IEE مای Nested Sensitive که در تمامی الکترونیکی IEEE ماین می دارد، دارای نزدیکترین پاسخ به نتایج آزمایشهای عملی دارد از IEE مای IEE که در تمامی الکترونیکی نتایج آزمایشهای عملی نشان میدهد. در نهایت مدل IEE های عملی است.

واژههای کلیدی: حجم حساس، آسیب GEANT4 ،SEU، حافظههای الکترونیکی

علائم و اختصارات

E _{dep}	انرژی برجای گذاشته شده
ρ	چگالی مادہ ھدف
LET	انتقال خطى انرژى
D	ضخامت حجم حساس
θ	زاويهٔ برخورد ذره با حجم حساس
L	طول مؤثر حرکت ذره در داخل حجم حساس

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد

مقدمه

محیط فضا شامل طیف گستردهای از تابشهای فضایی است که عمدتاً شامل پروتونها، الکترونها و یونهای سنگین پرانرژی است. این تابشها میتوانند آسیبهای گوناگونی را بر تجهیزات الکترونیکی، اجزای بنیادی تشکیلدهندهٔ واحدهای سختافزاری فضایی و زیرسیستمهای استفاده شده در ماهوارهها و فضاپیماها، فضایی و زیرسیستمهای استفاده شده در ماهوارهها و فضاپیماها، وارد سازند. یکی از اثرات تابش یون پر انرژی روی مدارهای الکترونیکی ایجاد خطای SEE⁴ یا حادثه تک رخدادی است. خطای SEE گونههای متفاوتی از قبیل SEU⁴، SEL⁷ و ... دارد.

4. Single Event Effect

۲. دانشیار (نویسنده مخاطب)

۳. کارشناسی ارشد

^{5.} Single Event Upset

در مورد مدارهای حافظه SRAM^۸ خطای SEU می تواند مقدار منطقی یک سلول از حافظه را معکوس کند و باعث از بین رفتن عدد واقعی ذخیره شده درون سلول شود. در شکل (۱) مدار داخلی یک سلول حافظه SRAM نشان داده شده است [۱].



شکل ۱ – مدار داخلی یک سلول حافظه SRAM

در حالت کارکرد عادی مدار مقدار ذخیره شدهٔ درون این سلول، توسط اعمال پسخورد از نقطهٔ A و B به گیتهای ترانزیستورهای مقابل، ثابت است. ترانزیستور Q1 دارای ولتاژ گیت صفر منطقی بوده بنابراین خاموش است و فقط جریان نشتی بسیار اندکی از آن عبور مى كند، اما به علت وجود اختلاف پتانسيل الكتريكى بين پایههای درین و سورس این ترانزیستور، یک میدان الکتریکی ایجاد می شود و الکترون – حفره های حاصل از یونیز اسیون ذرهٔ خارجی توسط این میدان جمع آوری می شود. جمع آوری این بارها باعث القای جریانی در ترانزیستور می شود. مقدار این جریان به پارامترهای مختلفي وابسته است كه مهمترين أن تعداد حامل هاي بار توليد شده از یونیزاسیون ذرهٔ ورودی است، بهطوری که هرچه مقدار بار تولید شده بیشتر باشد جریان بیشتری از ترانزیستور عبور میکند. اگر مقدار این جریان به اندازهٔ کافی زیاد باشد می تواند باعث شود که ولتاژ درین ترانزیستور Q1 به مقداری کمتر از یک منطقی افت کند، از طرفی با وجود بازخورد از نقطهٔ A به گیت ترانزیستورهای Q4، Q5، ترانزیستور Q4 به حالت خاموش و Q5 به حالت روشن هدایت می شوند و به این ترتیب سطح منطقی این سلول حافظه معکوس می شود. برای مدل سازی این پدیده باید مقدار بار تولید شده توسط ذرهٔ فرودی را درون حجم ترانزیستوری که ابتدا خاموش است

6. Single Event LatchUp

 $(\mathbf{1})$

- 7. Single Event Transient
- 8. Static Random Access Memory

محاسبه کرد. برای این کار حجم ترانزیستور را بهعنوان حجم حساس درنظرگرفته و مقدار انرژی برجای گذاشته شده توسط یون فرودی در این حجم محاسبه میشود. شکلها و مدلهای متفاوتی برای تقریبزدن این حجم ارائه شده است که سادهترین آن مدل PRP^e است [۵–۲]. با پیشرفت فناوری ساخت قطعات نیمههادی ابعاد ترانزیستورها به زیر میکرومتر کاهش پیدا کرده و مدل ساده RPP را نمیتوان برای شبیهسازی قطعات جدید استفاده کرد. به همین دلیل باید از مدلهای پیشرفتهتر برای مدلسازی این حجم حساس استفاده شود. پس از مدلسازی حجم حساس سلول حافظه الکترونیکی استفاده از مدلهای PRP و غیر PPP در کد مونت کارلو GEANT4 با استفاده از مدلهای RPP و غیر RPP در کد مونت کارلو GEANT4 نرژی برجای گذاشته شده توسط یونهای فرودی برای تخمین مقدار سطح مقطع آسیب SEU بر حسب TLE¹ محاسبه میشود. در ادامه مقادیر حاصل از مدلسازی حجم حساس، با مقادیر حاصل از اندازه گیریهای تجربی مقایسه و در نهایت بهترین مدل برای تعریف مقادیر حاصل سلول حافظه الکترونیکی معرفی میشود.

مدل RPP

این مدل، سادهترین راه برای درنظرگرفتن حجم حساس تعریف یک حجم هندسی به شکل مکعب مستطیل با ابعاد ثابت است، به گونهای که بهرهٔ جمع آوری بار در تمام این حجم مقدار ثابتی باشد (شکل ۲). SEU قدیمی مانند RPP سطح مقطع ایجاد خطای SEU برحسب LET ذرات، به صورت مستقل از انرژی و نوع ذره بیان میشود. با درنظر گرفتن LET ذرات به عنوان متغیر مستقل برای تابع سطح مقطع SEU آنرژی بر جاگذاشته شده توسط ذره ای با LET مشخص در طول مسیر D درون این حجم طبق رابطهٔ (۱) به دست می آید.

$$E_{dep} = \rho. \ LET. \ D$$



شکل ۲- هندسهٔ حجم حساس در مدل RPP

9. Rectangular Parallel Pipe 10. Linear Energy Transfer

برای تولید یک SEU در سلول حافظه، مقدار انرژی برجاگذاشته شده باید از انرژی آستانهٔ تولید آپست^{۱۱} بیشتر باشد، بنابراین اگر ذرهای بتواند در گذر از مسیری از درون این حجم، انرژی بیشتر از انرژی آستانه در این حجم به جای بگذارد باعث تولید یک خطای SEU می شود. طول مسیری که ذره در این حجم طی می کند عامل مهمی است که علاوه بر ضخامت خود این حجم به زاویهٔ برخورد ذره با این حجم نیز بستگی دارد [۵ و ۲]. همان طور که در شکل (۳) می کند طبق رابطهٔ رابط می کند از طول مسیر ذره ای این حجم عبور عبور می کند عامل می کند طبق رابطهٔ برخورد این حجم این حجم به زاویهٔ برخورد می می کند عامل زره با این حجم نیز بستگی دارد [۵ و ۲]. همان طور که در شکل (۳) می کند طبق رابطهٔ (۲) بیشتر از طول مسیر ذره ای است که به طور می کند طبق رابطهٔ (۲) بیشتر از طول مسیر ذره ای است که به طور عمود این ناحیه را طی می کند.





شکل۳– اثر زاویه بر طول مسیر مؤثر ذرهٔ فرودی

مدل های غیر RPP

در واقعیت، ناحیهٔ حساس یک شکل مکعبی با ابعاد ثابت ندارد، از طرفی بهرهٔ جمع آوری بار در تمام این حجم یکسان نیست و مقدار آن به میدان الکتریکی و میزان ناخالصی توزیع شده در نیمه هادی بستگی دارد [۸ و ۲].

در مدلسازیهای جدیدتر برای درنظرگرفتن این موضوع از هندسههای دیگری برای تعریف حجم حساس استفاده شده است. با درنظرگرفتن یک هرم به جای مکعب (در مدل هرمی^{۲۲})، سطح مقطع محاسبه شده برای SEU در LETهای پایین تا حد خیلی زیادی به مقادیر بهدست آمده از آزمایش نزدیک میشود [۶]. قاعدهٔ این هرم برابر اندازهٔ مساحت ترانزیستور حساس و ارتفاع آن معادل عمق بستر در سلول حافظه درنظرگرفته میشود. در این مدل ابعاد حجم حساس برای تمام ذرات یکسان و محدود به حجم ترانزیستور است و بهرهٔ جمعآوری بار در کل این حجم ثابت فرض میشود. در TETهای پایین پاسخ این مدل مناسب است ولی در TET

بالا دیده میشود که مقدار سطح مقطع اندازه گیری شده از آزمایش یک مقدار رو به افزایش دارد و سطح مقطع در LETهای بالا از مقطع هندسی خود ترانزیستور بزرگتر است. دلیل این مسئله جمعآوری بار از بیرون پیوند است که توسط دز شعاعی نسبتاً زیاد یونهای سنگین به وجود میآید [۱۱–۹]. این پدیده باعث می شود که میدان الکتریکی درون پیوند ترانزیستور از حالت متمرکز درون پیوند خارج شده و بتواند بارهایی را جمعآوری کند که بیرون از پیوند خود یک سلول حافظه می تواند از مساحت مقطع خطای SEU برای بزرگتر شده و برای ذرات سنگین حتی از مقطع کل سلول هم بیشتر مود. به عبارتی دیگر یک یون می تواند باعث کل سلول هم بیشتر میشود. یعنی به جای اینکه حجم حساس را درون ترانزیستور تعریف کنند آن را معادل مساحت کل سلول حافظه فرض کرده و بهرهٔ کنند آن را معادل مساحت کل سلول حافظه فرض کرده و بهرهٔ

در مدلهای جدید علاوه بر اصلاحات انجام شده روی شکل هندسی و بهرهٔ جمع آوری بار، ساز و کارهای برجا گذاشتن انرژی درون حجم حساس با دقت بیشتری بررسی می شود. پهن شدگی انرژی در حجمهای از مرتبهٔ میکرومتر بیشتر دیده می شود [۱۲]. اثر پهن شدگی انرژی برای ذراتی که LET نزدیک به مقدار LET آستانه (LETth) دارند، تأثیر زیادی روی نرخ خطای SEU دارد و برای تعیین سطح مقطع USE اثر این پدیده هم لحاظ می شود [۶]. در مدل سازی های پیشرفته تر از معماری واقعی داخل قطعه استفاده می شود و با درنظر گرفتن میدان الکتریکی درون ترانزیستورها، مقدار حقیقی بار جمع آوری شده توسط میدان الکتریکی محاسبه می شود [۳].

روش کار

برای محاسبهٔ سطح مقطع SEU باید مدلهای ارائه شده برای محاسبهٔ SEU را درون کد محاسباتی پیاده کرد و مقدار انرژی برجای گذاشته شده توسط یون را درون حجم حساس به دست آورد. برای این محاسبات از کد GEANT4 استفاده می شود. کد مونت کارلو GEANT4 بر مبنای زبان شیئ گرای ++C نوشته شده است و از این رو به راحتی توسعه پذیر است. این کد قابلیت های است و از این رو به راحتی توسعه پذیر است. این کد قابلیت های زیادی برای شبیه سازی انواع اندر کنش های فیزیکی مانند یونیزاسیون ذرات باردار، ترابرد فوتون های نوری، گاما، نوترون و دیگر ذرات است [۱۴]. هر اندر کنش فیزیکی در یک کلاس تعریف می شود و مجموعه ای از این اندر کنش ها یک لیست از

^{11.} Upset

^{13.} Nested volume

اندر کنشهای مورد انتظار را فراهم می کنند که فیزیک لیست نامیده می شود. برای محاسبهٔ مقدار انرژی بر جا گذاشته شده در این حجم حساس از فیزیک لیست استاندارد^{۱۴} استفاده شده است. در این فیزیک، ليست مقدار يونيزاسيون حاصل از يون هاى باردار، الكترون ها و غيره و همچنین اندرکنش گاما با ماده محاسبه می شود. مادهٔ درون حجم حساس از جنس سیلیکون با چگالی ۲/۳۳ گرم بر سانتیمتر مکعب است که سطح أن تحت تابش عمودی یونهای أورده شده در جدول (۱) قرار میگیرد. فرایند شبیهسازی بر اساس محاسبهٔ انرژی گذاشته شده از هر ذره فرودی به طور جداگانه است. شبیه سازی بر SRAM مدل AT60142 انجام می شود که از جمله قطعات حساس مورد استفاده در مدار یک کاوشگر فضایی است [۶]. در شکل (۴) هندسهٔ مورد استفاده در شبیهسازی نشان داده شده است، ناحیهٔ حساس برای مدل نستند سنسیتیو ولوم^{۱۵} مکعب بزرگتر است که در مکان های مختلف دارای بهرهٔ جمع آوری بار متفاوت است، هندسه RPP بهصورت خط چین و برای مدل هرمی بهصورت مثلثی با خط تو پر نشان داده شده است که مساحت مقطع بالایی آن معادل مساحت مقطع بالایی یکی از ترانزیستورهای تشکیل دهندهٔ سلول حافظه AT60142 است.

محاسبات به ترتیب برای مدل RPP و سپس پاسخ هندسهٔ هرمی با وجود اثر پهنشدگی انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر پاسخ مدل نستد ولوم محاسبه می شود. پاسخ این مدل ها در سه شکل مجزا با مقدار حاصل از نتایج آزمایشگاهی اندازه گیری سطح مقطع SEU برای این SRAM مقایسه شده است.

نام يون	انرژی یون (MeV)	انتقال خطی انرژی (MeV . cm ² / mg)			
¹⁵ ₇ N	१८४	١/٨۴٠			
²⁰ ₁₀ Ne	۱۸۶	٣/٧٢٠			
³⁰ ₁₄ Si	۲۷۸	۷/۰۴۴			
$^{40}_{18}Ar$	۳۷۲	۱۱/+۹			
⁵⁶ ₂₆ Fe	۵۲۳	K1/81			
⁸² ₃₆ Kr	ү۶д	۳۵/۹۹			
$^{131}_{56}Xe$	1717	۶۵/۵۰			

جدول ۱ – مشخصات یونهای استفاده شده در آزمایش [۶]

نتايج

برای محاسبهٔ پاسخ مدل RPP، حجم حساس یک مکعب مستطیل با ابعاد مقطع ۱ × ۰/۵۸ میکرومتر مربع و ضخامت ۱ میکرومتر

- 14. Standard EM Physics List
- 15. Nested sensitive volume

درنظر گرفته می شود. با توجه به مقادیر سطح مقطع بهدست آمده از آزمایش، آغاز ایجاد خطای SEU مربوط به تحریک توسط یون نیتروژن است. طیف انرژی بر جای گذاشته شده در حجم حساس توسط یون نیتروژن با انرژی ۱۳۹ مگاالکترون ولت در شکل (۵) نشان داده شده است. متوسط انرژی بر جای گذاشته شده از یون نیتروژن در هنگام عبور از حجم حساس برابر ۴۴۰ کیلوالکترون ولت است. با درنظرگرفتن این مقدار انرژی بهعنوان انرژی بحرانی، دیگر یونهای موجود در جدول (۱) که همگی دارای LET بیشتری نسبت به یون نیتروژن هستند، می توانند این انرژی را در حجم حساس بر جای بگذارند. بنابراین همان طور که در شکل (۶) نشان داده شده است، پاسخ مدل RPP در محاسبهٔ سطح مقطع آسیب SEU رفتار پلهای خواهد بود. از شکل مشخص است که سطح مقطع محاسبه شده در تمامی LETها تفاوت بسیار زیادی با سطح مقطع بهدست آمده از آزمایش دارد. به دلیل اینکه بهرهٔ جمع آوری بار و توزیع میدان الکتریکی در تمام حجم حساس یکسان نیست، باید از هندسههای دیگری استفاده کرد.

هندسهای که مورد استفاده قرار می گیرد، یک هرم با ارتفاع ۱ میکرومتر و مساحت مقطع ۱× ۸۵/۰ میکرومتر مربع است، سطح مقطع خطای بهدست آمده از این هندسه در شکل (۷) ارائه شده است. پاسخ مدل هرمی نشان می دهد که در LETهای پایین این مدل از نتایج بهدست آمده از آزمایش پیروی می کند، اما در LETهای بالا تفاوت زیاد شده به طوری که برای یون زینان مقدار سطح مقطع بهدست آمده از آزمایش ۰۰ برابر بزرگتر از مقدار محاسبه شده است. با اعمال تابع ویبال^{۱۰} روی سطح مقطع بهدست آمده از آزمایش، مقدار حداکثر سطح مقطع ۱۸ میکرومتر مربع بهدست می آید. با درنظر گرفتن این مقدار به عنوان مساحت حجم حساس و درنظرداشتن این واقعیت که بهرهٔ جمع آوری بار در این حجم تابعی نزولی از فاصلهٔ بین نقطهٔ برخورد یون و مرکز ترانزیستور است، منحنی شکل (۸) به عنوان تابع پاسخ قطعهٔ مدل سازی شده با استفاده از مدل نستد ولوم بهدست می آید.

همان طور که در شکل (۸) دیده می شود، مقدار سطح مقطع محاسبه شده برای بیشتر یونها از مدل نستد ولوم نزدیک به نتایج آزمایش است. بیشترین اختلاف دیده شده بین مدل نستد ولوم و آزمایش برای یون آهن است. این اختلاف حتی در مدلهای پیشرفته تر که معماری داخلی قطعه را وارد شبیه سازی می کنند نیز وجود دارد و یک مشکل عمومی در محاسبات SEU به شمار می رود. برای مقایسهٔ عددی، در جدول (۲) مقادیر محاسبه شده از مدل ها و مقادیر آزمایش آورده شده است. در سطر اول نام یون های استفاده

مدلسازی حجم حساس در محاسبهٔ سطح مقطع آسیب پرتویی SEU ناشی از پرتوهای فضایی

شده در آزمایش آورده شده، در سطرهای بعدی مقدار نتایج بهدست آمده از آزمایش و مدلهای محاسباتی نشان داده شده است. در دو سطر آخر مقدار خطای نسبی پاسخ مدل نستد ولوم نسبت به مقادیر آزمایش ۱ و ۲ آورده شده است.

نتيجه گيرى

پاسخ سه مدل محاسباتی مطرح شده برای مدلسازی ناحیهٔ حساس در ایجاد خطای SEU نسبت به مقادیر آزمایش مقایسه شد. با توجه به نتایج بهدستآمده، سطح مقطع خطای SEU برای یونهای سنگین از ابعاد ترانزیستورهای تشکیلدهندهٔ سلول حافظهٔ بزرگتر است. بنابراین مدلهای با ابعاد ثابت و محدود به اندازهٔ ترانزیستور درون سلول نمیتوانند پاسخ مناسبی برای یونهای سنگین ایجاد کنند. به عبارتی ناحیهٔ حساس مورد نظر محدود به ابعاد ترانزیستور نیست. مدل PR در تمامی ETLها پاسخ مناسبی ارائه نمیدهد، SEU مدل هرمی فقط در LET های پایین که سطح مقطع خطای SEU کمتر از مقطع هندسی ترانزیستور است پاسخ قابل قبولی دارد و در نهایت مدل نستد ولوم نزدیکترین پاسخ به نتایج تجربی است.



شکل ۴- هندسهٔ استفاده شده برای شبیهسازی AT60142 در کد GEANT



شکل ۵– طیف انرژی بر جای گذاشته شده در حجم حساس توسط یون نیتروژن با انرژی ۱۳۹ مگا الکترون ولت





شکل ۶– سطح مقطع آسیب SEU بهدست آمده بر حسب LET با استفاده از مدل RPP



شکل ۷- سطح مقطع آسیب SEU بهدست آمده بر حسب LET با استفاده از مدل هرمی



شکل ۸- سطح مقطع آسیب SEU بهدست آمده بر حسب LET با استفاده از مدل نستد ولوم

نام يون	N	Ne	Si	Ar	Fe	Kr	Хе
دادههای آزمایش ۱ [۶]	۶×۱۰ ^{-۱۲}	۲×۱۰ ^{-۹}	۴×۱۰ ^{-۹}	۱×۱۰ ^{-۸}	۱/۲×۱۰ ^{-۸}	۲/۳×۱۰ ^{-۸}	۴/۱×۱۰ ^{-۸}
دادههای آزمایش ۲ [۶]	۲×۱۰ ^{-۱۲}	٣/۵×١٠ ^{-٩}	۵×۱۰ ^{-۹}	۱/۱×۱۰ ^{-۸}	۱/A×۱۰ ^{-۸}	٣/٢×١٠	۵/۳×۱۰ ^{-۸}
مدل RPP	۱/∆×۱۰ ^{-۹}	•/۵۸×١٠ ^{-٨}	۰/۵۸×۱۰ ^{−۸}	۰/۵ ۸ ×۱۰ ^{−۸}	•/۵۸×۱۰ ^{−۸}	۰/۵۸×۱۰ ^{−۸}	۰/۵۸×۱۰ ^{−۸}
مدل هرمی	۶/•۳۷×1• ⁻¹¹	۱/۳۲۱۵×۱۰ ^{-۹}	۳/۰۸×۱۰ ^{-۹}	4/	4/8224×1+-+	۵/۲۶۷۴×۱۰ ^{-۹}	۵/۵۰۳۵×۱۰ ^{-۹}
مدل نستد ولوم	۵/۲۴۶×۱۰ ^{-۱۲}	।/ ⋏ ९९٣×।∙ ^{-९}	۵/ <i>۸۶۶</i> ×۱۰ ^{-۹}	۱/۳۱۶×۱۰ ^{-۸}	۲/۹۴۵×۱۰ ^{-۸}	۲/٩۶٣×١٠ ^{-٨}	۶/۶۶۳×۱۰ ^{-۸}
خطای نسبی مدل نستد ولوم به آزمایش ۱ (درصد)	۱۲/۵	۵	48/8	۳١/۶	140/4	۲۸/۸	۶۲/۵
خطای نسبی مدل نستد ولوم به آزمایش ۲ (درصد)	۲۵	۴۵/۷	۱۷/۳	۱۹/۶	83/8	٧/۴	۲۵

جدول ۲ – مقادیر سطح مقطعهای آسیب SEU محاسبهشده بر حسب [cm²/bit] با استفاده از مدل های RPP ، هرمی و نستد ولوم و مقایسهٔ آنها با دادههای تجربی

- [7] Streetman, B. G., Solid State Electronic Device, 4th Edition, Prentice Hall, 1995, pp.51-90.
- [8] Jasprit, S., An Introduction to Semiconductor Devices, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1994, pp.12-53.
- [9] Fageeha. O., Howard, J. and Block, FL., "Distribution of Radial Energy Deposition around the Track of Energetic Charged Particles in Silicon," *Journal of Applied Physics*, Vol. 75, No. 5, 1994, pp.2317-2321.
- [10] Zoutendyk, J. A., Crescenta, La, Malone, C. J., Method of Measuring Field Funneling and Range Straggling in Semiconductor Charge Collection Junctions, Washingtown Dc, (United States Patent), 1987.
- [11] Bertrand, J. and Renaud, N., Single Event Transients Characterisation of ATC18RHA ASIC Family, (Workshop) Aerospace Marketing Engineer – Processors & Radiation Aspects, 2007.
- [12] Barak, J. and Akkerman, A., "Straggling and Extreme Cases in the Energy Deposition by Ions in Sub-Micron Silicon Volumes", *IEEE Transactions on Nuclear Science*, Vol. 52, No. 6, 2005, pp. 2175-2181.
- [13] Ke-Ying, Zh., Hong-Xia, G., Yin-Hong, L., "First Principles Simulation Technique for Characterizing Single Event Effects", *Journal of Chinese Physics B*, Vol. 20, No.6, 2011, pp.46-57.
- [14] Geant4 Physics Reference Manual, Available, [on line]: http://geant4.web.cern.ch/geant4/, 2011, pp. 201-212.

مراجع

- Jahinuzzaman, S. M., Modeling and Mitigation of Soft Errors in Nanoscale SRA Ms. (Ph. D. Thesis) University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, 2008, pp.28-89.
- [2] Peterson, E. L., "Geometrical Factors on SEE Rate Calculations," *IEEE Transactions on Nuclear Science*, Vol. 44, No. 6, 1993, pp.1888-1909.
- [3] Duzellier, S. and Inguimbert, C., "SEU Rate Calculation with GEANT4 (Comparison with CREME 86)", *IEEE Transactions on Nuclear Science*, Vol. 51, No. 5, 2004, pp.2805-2810.
- [4] Connell, L.W., Sexton, F.W. and Prinja, A. K., "Further Development of the Heavy Ion Cross Section for Single Event Upset", *Sandia National Laboratories*. *Albuquerque*, New Mexico, 1997.
- [5] Dodd, P. E, Shaney felt, M. R and Sexton, F. W., *Charge Collection and SEU from Angled Ion Strikes*, Report of Sandia National Laboratories, Albuquerque, Mexico, 1997.
- [6] Keating, A. and Oliveira, B., Mars Radiation Environment and Effects on EEE Components, (Ph.D. Thesis), Lisbon, 2008, pp.142-202.